

RESINES EPOXY, BICOMPOSANT POUR APPLICATIONS OPTIQUES, COLLAGE STRUCTURAL ET MOULAGE*

REF	RAPPORT MELANGE	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE Après mélange	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
								AVANT TG	APRES TG		
E501	4/1	12/24 h à 25°C	1 h à 25°C	0,2 Pa.S	50-70°C	310-330°C		70-80.10 ⁻⁶ /°C	240-260.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Collages optiques - Résine liquide incolore Existe aussi en versions thixotropes non transparentes : E501Si, E501SiT, E501T et E501TT
E504	5/1	48 h à 25°C	2 h à 25°C	4 Pa.S	60-70°C	340-360°C	24%	60-70.10 ⁻⁶ /°C	120-140.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Résine semi souple pour enrobage - Norme UL94VO - Liquide - Blanche
E504T	10/0,5	48 h à 25°C	2 h à 25°C	8 Pa.S	70-80°C	340-360°C	27%	60-70.10 ⁻⁶ /°C	120-140.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Résine semi souple pour enrobage - Norme UL94VO - Thixotrope - Blanche
E505	10/1	1 min à 150°C	4 h à 25°C	1,6 Pa.S	105-115°C	380-400°C		60-70.10 ⁻⁶ /°C	140-160.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Collage des fibres optiques dans connecteurs - Fort effet de mesh - Peut être colorée en noire Existe aussi en versions thixotropes : E505Si, E505SiT, E505T et E505TT
E507	1/0,28	2 h à 125°C	4 h à 25°C	1,2 Pa.S	105-115°C	380-400°C				10 ¹⁶ Ω.cm	Collage de ferrites
E507-4	1/1	10 min à 150°C	8 h à 25°C	22,5 Pa.S	160-170°C	370-380°C	81%	17-20.10 ⁻⁶ /°C	65-70.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs dans le domaine des cartes à puces
E510	10/1,1	24/48 h à 25°C	1 h à 25°C	6 Pa.S	90-100°C	340-360°C	45%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	150-180.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Liquide Rigide - Noire
E511	10/0,6	48 h à 25°C	1 h à 25°C	13 Pa.S	60-80°C	340-360°C	45%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	150-180.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Thixotrope Rigide - Noire
E512	10/2	48 h à 25°C	15 à 30 min à 25°C	5 Pa.S	60-70°C	340-360°C	20%	60-70.10 ⁻⁶ /°C		10 ¹³ Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Liquide - Semi souple - Noire
E512-2	10/0,5	48 h à 25°C	1 h à 25°C	5 Pa.S	60-70°C	340-360°C	20%	60-70.10 ⁻⁶ /°C		10 ¹³ Ω.cm	Enrobage de composants passifs - Conforme UL94Vo
E513	1/1	20 min à 140°C	8 h à 25°C	30 Pa.S	125-130°C	400-410°C	70%	35-40.10 ⁻⁶ /°C	100-120.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Réalisation d'isolateurs haute tension -Très bonne conduction thermique
E514	1/1	2 h à 100°C+4 h à 160°C	8 h à 25°C	100 Pa.S	150-160°C	340-350°C	65%	20-30.10 ⁻⁶ /°C	60-70.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Protection des semi-conducteurs - Dépôt à la goutte - Noire - Haut degré de pureté
E515	4/1	12/24 h à 25°C	1 h à 25°C	40 Pa.S	50-70°C	310-330°C	16%	70-80.10 ⁻⁶ /°C	240-260.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹³ Ω.cm	Résine très thixotrope pour collage sans fixation spécial - Blanche
E516	100/3	30 min à 120°C	16 h à 25°C	80 Pa.S	70-90°C	400-410°C	73%	30-40.10 ⁻⁶ /°C	100-120.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Enrobage d'appareillages à noyau métallique Haute conductivité thermique - Bleue
E520	1/1	3 à 6 h à 25°C	10 min à 25°C	9 Pa.S						10 ¹³ Ω.cm	Résine transparente et incolore - Prise rapide
E521	3,35/1	2 h à 65°C	20 min à 20°C	27 Pa.S	100°C	340-360°C	44%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	150-160.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Résine de protection, blanche - Faible dilatation thermique
E522	2,43/1	20 min à 65°C	20 à 30 min à 25°C		120°C	340-360°C		70-80.10 ⁻⁶ /°C	150-160.10 ⁻⁶ /°C	10 ¹⁵ Ω.cm	Résine de protection, blanche - Faible dilatation thermique - haute tenue en température
E525	10/1	45 min à 85°C	4 h à 25°C	30 Pa.S	105-120	400°C		65-70.10 ⁻⁶ /°C		10 ¹³ Ω.cm	Collage structural de grandes pièces - Haute tenue en température
E526	2/1	15 min à 65°C	20 min à 25°C	40 Pa.S	95	400°C		20.10 ⁻⁶ /°C		8.10 ¹⁴ Ω.cm	Faible coefficient d'expansion thermique. Bonne résistance aux agents chimiques.

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 24/04/2008